

NF 158R 填料助焊劑底部填充劑產品資料表

卓越的熱循環性能
優異的機械衝擊性能
高良率

簡介

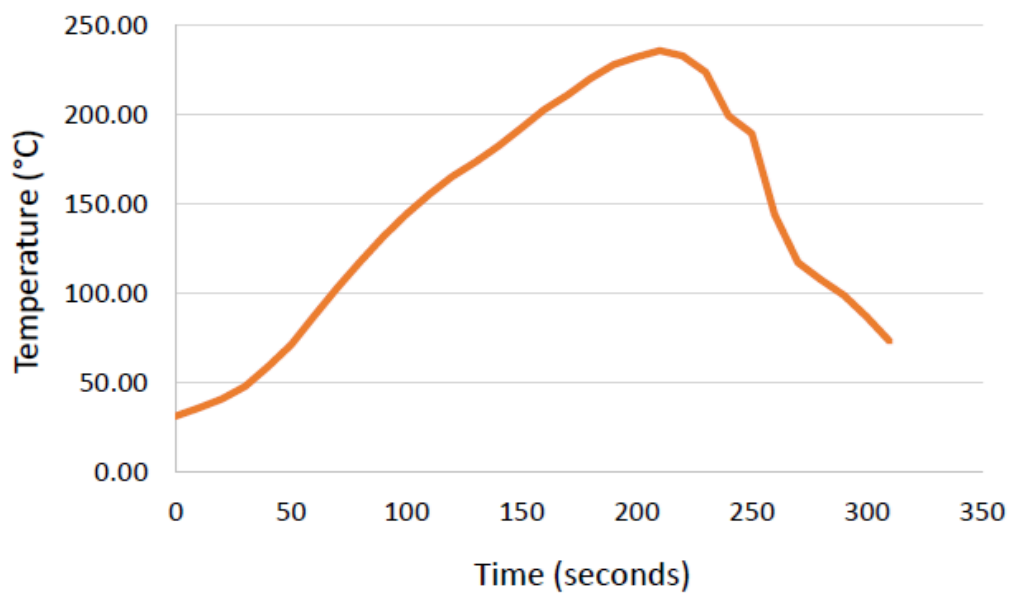
NF 158R 是一種填充型助焊液態環氧底部填充膠，适用于Flip Chip、CSP、BGA、PoP以及LGA等应用。同时，可为先进封装中的裸芯片提供可靠保护，包括存储卡封装、IC 载体封装、混合集成电路(HIC)以及多芯片模块(MCM) 等应用。該產品專為高產量和環保生產環境而設計，尤其適用於對製程速度和機械衝擊性能要求較高的應用。這種材料易於點膠，可最大限度地減少應力，並提供卓越的可靠性性能(例如溫度循環性能)和出色的機械強度。與使用焊膏相比，其跌落測試性能提高了兩個數量級。

物理特性

产品名称	NF 158R 填充助焊劑底部填充膠
外觀	白色
未固化材料性能	
项目	数值
比重(ASTM D 1475-60)	1.5 g/cc
黏度(Brookfield, 0.5 rpm)	70 – 120 kcp
固化材料特性	
Tg (ASTM D3418-82)	125 °C
表面絕緣電阻 (FR4/FR4)	經過
C.T.E.(ASTM E 831) ppm/°C	1 = 50; 2 = 135
搭接剪切強度 (FR4/FR4)	2600 psi

提取离子(MIL-STD-883E)	
离子种类	含量
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm
表面絕緣電阻	Pass

推荐干燥/固化工艺



储存与保质期

在 -40 °C 以下条件下, 如材料保持于密封的原始容器中, 保质期为 6 个月。
超过该存储期限, 材料粘度可能会升高。请避免材料受到水分、挥发损失及异物污染, 否则可能对产品的加工性能产生不利影响。

安全信息

NF 158R 为环保型、无毒材料。但在操作和使用过程中, 仍建议遵循基本的工业卫生规范。有关更详细的安全信息, 请参阅本产品的 材料安全数据表。

包装规格

NF 158R 系列填充型助焊剂底部填充材料现已上市 10cc 和 30cc 两种规格。其他包装规格可依客户需求提供。如需订购信息, 请联系 YINCAE 公司。